

USB3.1C S1H DN1 RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Версия	Данные OMNIMATE – штекер USB, Штекеры USB, 10 Гбит/с, Соединение под пайку для поверхностного монтажа, 90°, ≥ 10000, Шаг в мм (P): 0.50 mm, Количество полюсов: 24, LCP, черный, Катушка
Заказ №	2987560000
Тип	USB3.1C S1H DN1 RL
GTIN (EAN)	4099986855052
Кол.	1 050 Шт.
Упаковка	Катушка

Дата создания 4 июня 2024 г. 2:59:05 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	7,9 мм	Глубина (дюймов)	0,311 inch
Высота	3,21 мм	Высота (в дюймах)	0,126 inch
Ширина	8,94 мм	Ширина (в дюймах)	0,352 inch
Масса нетто	10 g		

Упаковка

Упаковка	Катушка	Длина VPE	0
VPE с	0	Высота VPE	0

Системные характеристики

Боковая панель, свойства	Нет	Вид защиты	IP20
Выводы для экранирования	нет	Длина штифта для припайки (l)	1,15 мм
Категория эксплуатационных характеристик	10 Гбит/с	Количество контактных штырьков на полюс	1
Количество полюсов	24	Материал экрана	Латунь
Монтаж на печатной плате	Соединение под пайку для поверхностного монтажа	Поверхность экрана	никелированный
Серия изделия	Данные OMNIMATE – штекер USB	Скорость передачи	10 Гбит/с
Техпроцесс пайки	Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную	Угол вывода	90°
Циклы коммутации	≥ 10000	Шаг в дюймах (P)	0,02 "
Шаг в мм (P)	0,5 мм	Экранирование	Контакт с экраном 360°

Электрические свойства

Номинальное напряжение	5 V	Прочность изоляции	≥ 100 MΩ
Электрическая прочность, контакт / контакт	750 V AC		

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Прочность изоляции	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал контактов	Сплав медный	Материал контакта	Золото поверх никеля
Поверхность контакта	Золото поверх никеля	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Рабочая температура, макс.	80 °C		

Классификации

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01		

Загрузки

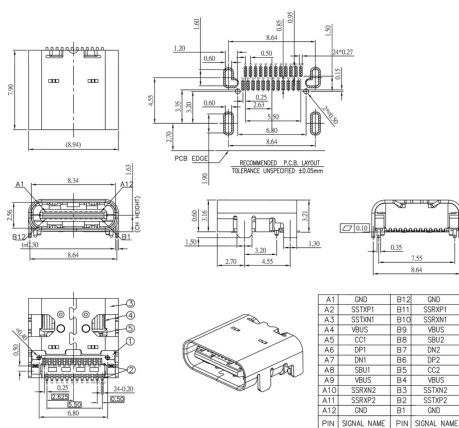
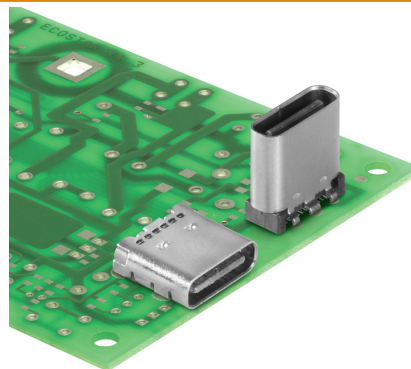
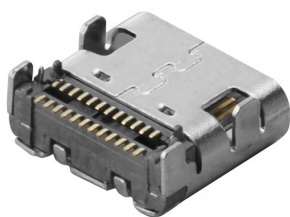
Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

USB3.1C S1H DN1 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.